

1

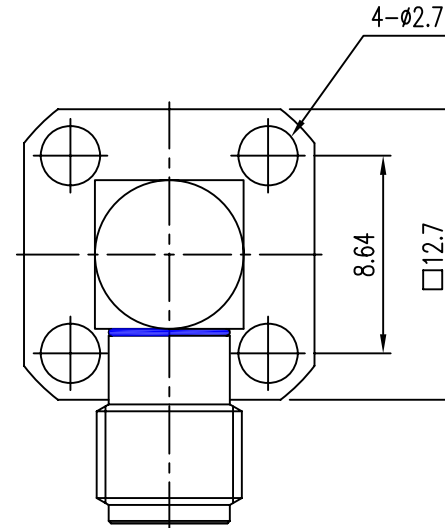
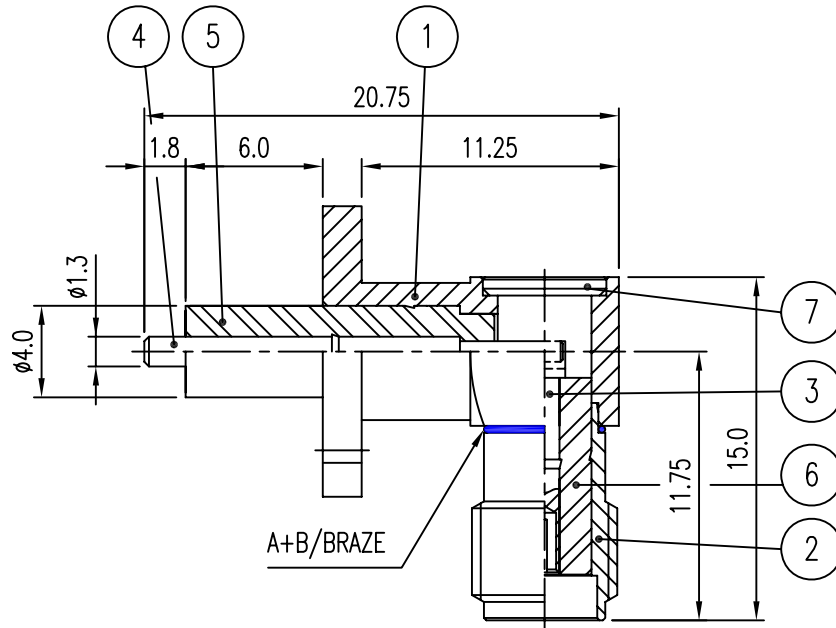
2

3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	생산상 불량(실변No. 2005-168) (멤공경시 PIN 밀림현상 개선으로 인한 납시배를 추가)	김인철	최종락	2005. 7. 20.
2	신뢰성 향상 (실변No. 2006-149) (PIN 밀림 방지 납시배를 삽입)	김인철	윤상진	2006. 7. 27.
3	바디 PUNCH -> HOOK 변경 및 A+B/온뎀 구조 변경	은선영	김인철	2021. 6. 01.



7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00041-5/2 (L3009)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00112-N/1 (H2031)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01239-N/1 (H2105)
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01251-5/1 (E2133)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00151-5/1 (E2127)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD02134-1/3 DBD00167-5/3 DBD00269-1/4
1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00069-5/4 DBD00229-1/5 DBD00228-1/4

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차	년월일		2004. 11. 30.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
소수 각도 분수	승인			 도명			
재질	검도						
열처리	재도						
보호피막처리	검도			작성부서		A4	
	적도	NS	단위 mm	총량	연 구 소		
						도번	CN01698-7/1
							K314-620-002

1

2

3

4